

※サムスン電子(韓国本社)配信のコンテンツを翻訳した内容です。
※使用できる機能は国・地域・OS バージョン、デバイスのモデルなどによって異なります。

<報道関係者各位>

ブロードコム社とメモリおよびファウンドリ技術分野で 戦略的協業を拡大

次世代 AI インフラを支える最先端メモリ、ファウンドリ技術、先端パッケージングの
協業拡大で覚書を締結

サムスン電子株式会社(韓国本社、以下 Samsung)とブロードコム社は 2026 年 8 月 25 日、次世代 AI インフラを支えるメモリおよびファウンドリ技術分野において、戦略的協業を拡大する覚書を締結しました。

本覚書はサンフランシスコの The Midway で開催された「AI サミット」の場で発表されました。同イベントには、サムスン電子 社長 兼 ファウンドリ事業部長の Jinman Han、ブロードコム社 社長 兼 CEO の Hock Tan 氏をはじめ、両社の経営幹部や韓国政府関係者が出席しました。

両社は、2030 年までの今後 5 年間で、メモリおよびファウンドリ両分野の協業規模が 2,000 億ドルを超えると見込んでいます。

メモリ分野では、ブロードコム社の次世代の半導体チップである AI アクセラレータ向けに、高帯域幅メモリ(HBM)をはじめとする業界最高水準のメモリソリューションを供給すべく、両社で戦略的な協業を進める計画です。

ファウンドリ分野では、無線ブロードバンド通信(WBC)ソリューションをはじめとするブロードコム製品を対象に、Samsung の 2 ナノメートル(nm)以下の最先端プロセス技術を軸に協業を進めます。さらに、より高性能かつ低消費電力な AI・ネットワーキング向け半導体の実現に向け、Samsung の 2nm プロセスを基盤とした 2.3D・2.5D 統合をはじめとする先端パッケージング技術にも協業範囲を広げていく方針です。

サムスン電子 副会長 兼 DS(Device Solutions)部門 CEO Young Hyun Jun は、次のように述べています。「AI の進化はメモリ、ロジック、先端パッケージングを横断する高度な半導体統合技術に対し、かつてない規模の需要を生み出しています。こうした重要な領域におけるブロードコム社との協業を拡大することで、お客様により大きな価値を提供するとともに、未来の AI インフラの発展に貢献していきたいと考えています。」

ブロードコム半導体ソリューショングループ社長の Charlie Kawwas 氏は「AI インフラの拡大が続く中、半導体エコシステム全体における緊密な協業の重要性がますます高まっています。Samsung が持つメモリ・ファウンドリ分野の強みと、ブロードコムの AI・接続技術におけるリーダーシップを組み合わせることで、次世代 AI

インフラを支える技術を今後も提供していきます。」と述べました。

メモリ、ロジック、ファウンドリ、先端パッケージングを網羅した技術力を有する Samsung は AI 時代に向けた統合型半導体ソリューションを提供できる独自の立場です。今回のブロードコム社との協業拡大は多様化する AI・高性能コンピューティング分野の用途が多様化する中、設計から製造までを一貫して支えるエンドツーエンドの半導体技術を通じてお客様をサポートするという Samsung の姿勢を示すものです。

●「Samsung Galaxy」は Samsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。